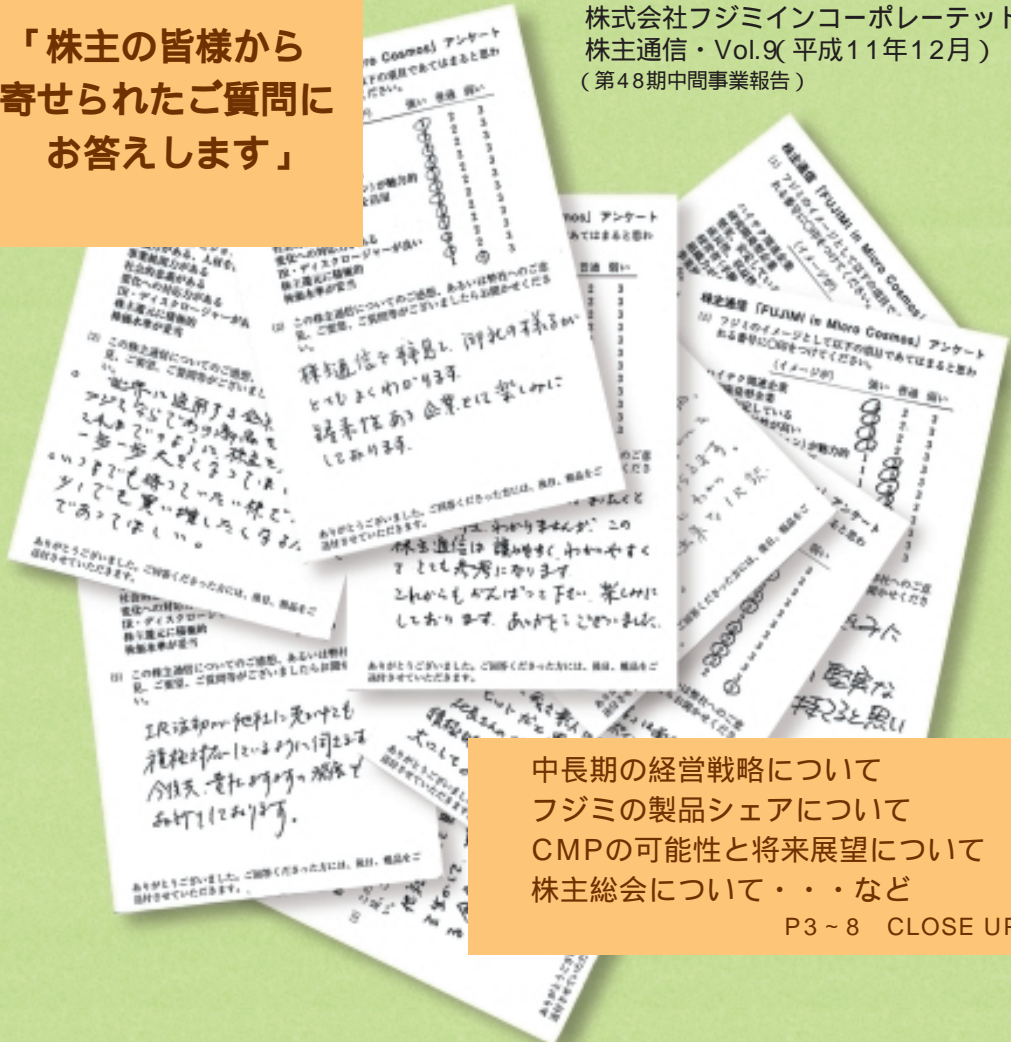


### 特集

「株主の皆様から  
寄せられたご質問に  
お答えします」

株式会社フジミインコーポレーテッド  
株主通信・Vol.9(平成11年12月)  
(第48期中間事業報告)



中長期の経営戦略について  
フジミの製品シェアについて  
CMPの可能性と将来展望について  
株主総会について・・・など

## 決算ハイライト

(単位：百万円、百万円未満は切り捨てています。)

	第48期中間期 平成11年9月30日現在	第47期中間期 平成10年9月30日現在	第47期 平成11年3月31日現在
売上高	<b>10,259</b>	12,882	23,477
営業利益	<b>1,959</b>	2,031	4,134
経常利益	<b>2,003</b>	1,994	4,383
中間(当期)純利益	<b>1,100</b>	1,173	2,546
総資産	<b>38,750</b>	38,419	36,908
株主資本	<b>31,404</b>	29,400	30,594
一株当たり			(単位：円)
株主資本	<b>2,012.78</b>	1,884.36	1,960.88
配当額	<b>12.50</b>	11.50	25.00
中間(当期)純利益	<b>70.53</b>	75.19	163.22

## 平成11年度(第48期)中間決算のポイント

### 売上、経費、利益面

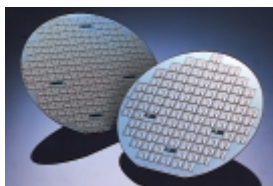
シリコンウェファー用ラッピング材およびポリシング材の売上高は、半導体市況の回復により増加しましたが、ディスク用ポリシング材はハードディスクドライブに搭載されるディスク枚数が短期間に減少したことにより、前年を大きく下回りました。また、機械等商品の売上高も減少した結果、売上高は前年同期比で20.4%の減少となりました。営業経費面では商品仕入が大幅に減少しましたが、研究開発の強化に伴う人員増による人件費の負担増もあり、営業利益、経常利益、中間純利益はそれぞれ前年同期比マイナス3.5%、プラス0.5%、マイナス6.2%となりました。

### 財務面

当中間期の設備投資額は5.7億円、海外子会社に対する直接貸付を2.7億円実施しています。当期は新研究所の建設を予定しており、借入金によりその一部として9億円調達いたしました。

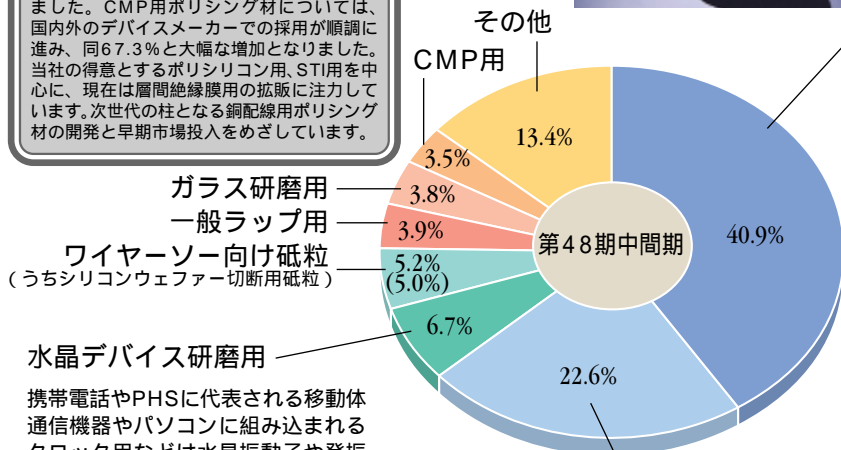
## 主要用途別の製品売上高の特徴

**ワイヤーソー向け砥粒以下その他売上高の特徴**  
 ワイヤーソー向け砥粒は全体として前年同期間比13.2%増となりました。いち早く半導体不況を脱し、回復基調にある海外向けにおいては、同139.4%と大幅増加となりました。ガラス研磨用は、一般消費の低迷が前期より引き続いており、同8.8%の減少となりました。CMP用ポリシング材については、国内外のデバイスメーカーでの採用が順調に進み、同67.3%と大幅な増加となりました。当社の得意とするポリシリコン用、STI用を中心に、現在は層間絶縁膜用の拡販に注力しています。次世代の柱となる銅配線用ポリシング材の開発と早期市場投入をめざしています。



### シリコンウェファアのラッピング・ポリシング用

コンピュータを中心に、OA機器やAV製品など、電子産業関連機器類の心臓部に使用されている半導体素子。この半導体素子を製造するには、シリコンウェファアに代表される半導体基板を高精度に鏡面研磨しなければなりません。フジミのラッピング、ポリシング材はこの分野で高いマーケットシェアを誇っています。



### 水晶デバイス研磨用

携帯電話やPHSに代表される移動体通信機器やパソコンに組み込まれるクロック用などは水晶振動子や発振子が使われています。この分野においても、フジミの研磨材はリーディングカンパニーとしてのポジションを確立しています。



### 売上高の特徴

長期不況下における消費低迷の影響をまともに受けてきた水晶業界も、ここに来て水晶デバイスの供給不足感が強まり、復調の兆しが見えてきました。主に携帯電話用や情報機器用が好調で、精密仕上用ラッピング材の出荷額は、前年同期間比4.1%の増加となりました。水晶デバイスの生産拠点はコスト競争力の強化のため、中国や東南アジアへのシフトが進んでおり、国内向けが同3.0%の減少となったものの、海外向けについては同37.1%と大幅な増加となりました。

### ディスクポリシング用

パソコンの高機能化に伴い、プログラムやデータの高速読み出しが可能な小型・大容量メモリーのハードディスクが注目を集めています。このため、ディスク研磨についても、より高精度な水準が要求されるようになりました。フジミはこの分野でも世界的に高い評価を得ています。



### 売上高の特徴

ウェファア需要はチップシュリンクなどの微細化技術の進展で低迷が続いていましたが、パソコンや携帯電話市場の堅調な推移、DRAM（記憶随時書き込み読み出しメモリ）市況の急回復により、需要も確実に伸びてきています。在庫の一巡、一般消費の回復が今春より見え始め、夏にはフル稼働となり、ウェファア用ラッピング材ならびにポリシング材は10.5%の増加となりました。特に海外向けのラッピング材は46.9%と顕著な伸びを示しています。

### 売上高の特徴

膨大な情報を処理するため、パソコンの高機能化は非常に速く進んでおり、より大容量、高記録密度のディスクが必要となってきました。それに伴い、ディスクポリシング材にも非常に高度な研磨特性が求められるようになってきています。昨年までのセミスーパーからスーパーポリッシュへ、さらに最近ではウルトラスーパーポリッシュへとグレードアップしています。一方、高記録密度化およびパソコンの低価格化が進んだ結果、HDD（ハードディスクドライブ）1台に搭載されるディスクの枚数が短期間に減少したため、ディスク生産総枚数が伸びず、当社のディスクポリシング材の出荷額は前年同期間比26.0%の大幅減少となりました。

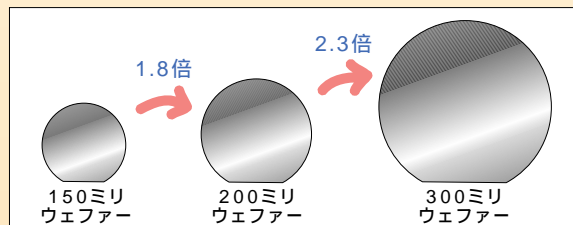
# CLOSE UP . . . フジミの事業をご理解していただくために

## 特集:「株主の皆様から寄せられたご質問にお答えします」

株主通信の前号で読者アンケートをしましたところ、450通を超える返答ハガキをいただきました。これも株主の皆様の当社に対するご期待の表れと、ただただ感謝を申し上げる次第です。今号では、その中から代表的なご質問を選んでお答えすることにいたしました。誌面の制約等で掲載されなかったご質問についても、機会を見て可能な限りお答えしていこうと考えています。

**Q1** もうすぐ300mm（12インチ）ウェファアの時代がやってくると言われています。300mmに向けた取り組みはどこまで進んでいるのでしょうか。（愛知県 65歳 男性）

**A1** 300mmウェファアの採用は2002年頃から始まり、主流になるのは2015年頃とされています。200mmの場合とは異なり、ウェファアの両面を鏡面にする方式がとられること、加工精度や清浄度がより厳しくなることなどが特徴です。当社では、300mmに対応したスラリーの開発にはすでに取り組



半導体生産の効率化とコストの低減をめざし、1枚のシリコンウェファアから採れる半導体チップの数を増やすために、シリコンウェファアの口径は徐々に大きくなってきました。現在主流の200ミリから300ミリへ移行することで、半導体チップの採取数は約2.3倍になると見込まれています。

んでおり、お客様に試作品の評価をしていただいている段階です。また、来年10月から稼働予定の研究開発センターにおいて研削技術も視野に入れて300mmウェファア加工技術を中心に新たな商品開発を計画しています。さらに400mmウェファアについてもSSI（スーパーシリコン研究所）と連携して新しい加工プロセスに適したスラリーの開発を進めているところです。

**Q2** 半導体関連はたえず大きな変化が押し寄せています。そうした中で、フジミは今後どのような戦略をもって取り組んでいかれるのでしょうか。中・長期計画のようなものがありましたら、それと一緒にご紹介ください。（千葉県 62歳 男性）

**A2** 当社が主要な取引先としている半導体市場は、いわゆるシリコンサイクルと呼ばれる好不況の波にたえず影響されるため、中・長期計画の作成そのものが極めて困難な状況にあります。しかし、当社が公開企業として成長し、株主様のご期待に応えるためにも、全社共通の目標がなければならず、社長直轄の経営企画室を中心に、社内から人選された中長期経営

計画策定委員によって中・長期計画が策定されています。これらは公表しておりませんが、常に経済情勢や市場動向の変動に即応してローリングをかけ、年度ごとに方針および方針管理活動を軌道修正し、常に最適なものになるよう努めています。現在、私どもが計画をもとに全社一丸となって取り組んでいる目標をいくつかご紹介すると、表面精度や清浄度が一層厳しくなる300mmおよび400mmウェファアの加工技術の開発、超高鏡面化と加工コスト低減を両立させるディスクの加工プロセスならびにスラリーの開発、シリコンウェファアの加工技術（スライス、ラップ、ポリッシュ）をコア技術としてデバイス側でも導入されたCMP技術への応用展開、そして新規分野への事業展開などがあげられます。なかでも新規事業については、当社の既存用途に縛られない機能材と称する新しい分野での商品開発に力を入れていきたいと考えています。

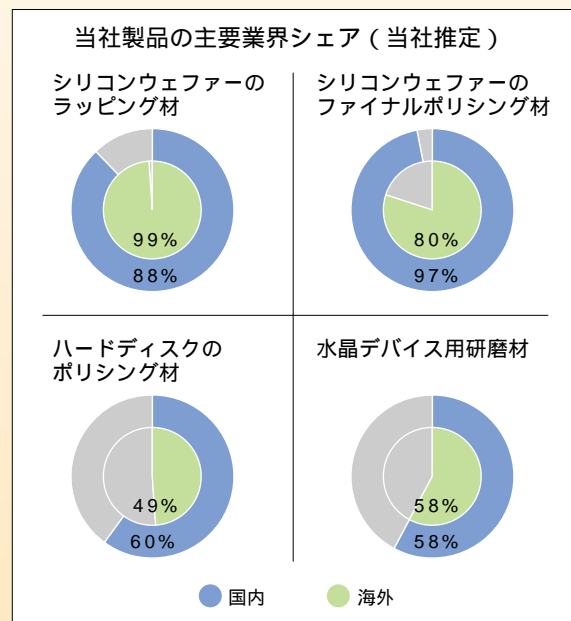
**Q3** ポリシング技術はレンズや半導体の研磨以外にも応用できないのでしょうか。凄い技術力だと聞いているだけについていそんなことを考えてしまいます。(大阪府 35歳 男性)

**A3** ポリシング技術はすでに幅広い分野で応用展開されています。たとえば、半導体デバイスに回路を描くためのガラス基板であるフォトマスク、振動子やフィルターの役目をする水晶や酸化物質結晶、カメラやプロジェクターなど各種光学機器用プリズムなどが一例です。さらにポリシングに限定せず、広くパウダーというカテゴリーで見ますと、粉体そのものが持つ物理特性を利用して塗料、金属複合材、高電圧用端子などに使われたり、各種部品の表面形状を整えたり、硬度を高めたりする用途にも使われています。いずれ

にしても、「お客様の要求に合わせて粒をそろえる」という技術をコアとして、磨きにとどまらず、幅広い用途に応用展開ができると考えています。

**Q4** フジミの主要製品の国内および海外におけるシェアを教えてください。それぞれの製品の強みが一目でわかると思うのですが。(兵庫県 69歳 男性)

**A4** 当社の主要製品のシェアは次の図のとおりです。強みをご理解いただければ幸いです。



**Q5** 半導体の製造工程ではCMP（化学的機械的研磨）という方法が注目を集めていると聞きました。CMPの可能性と将来展望、そしてフジミの取り組みについて教えてください。(愛知県 46歳 男性)





CMPスラリー「PLANERLITE」

**A5** CMPとは、半導体の製造工程における平坦化技術のひとつです。この分野における当社の売上は、2年連続倍々のペースで拡大しています。当社としても第4の柱としてこれを位置づけ、先行企業に追いつき追い越せをスローガンに、CMP用の研磨材であるCMPスラリーの研究開発に力を注いでいます。現在、当社の各種CMPスラリーが、国内外のデバイスメーカーで採用実績を拡大させており、従来競合他社が押さえていたユーザー数社にもセカンドベンダーとして新規参入するなど順調にシェアを伸ばしています。また、こうした需要の伸びに対応するため、各務原工場およびフジミアメリカにおけるCMPスラリー増産設備工事も予定どおり進んでいます。さらに、次世代銅配線向けスラリーの開発にも積極的に取り組んでいます。

**Q6** 半導体製造工程の変遷により、各種の研磨材が不要になるということはないのでしょうか。技術の素人なのでそのようなことがとても気になります。  
(大阪府 35歳 男性)

**A6** 日進月歩のスピードで変化する半導体製造工程だけに、現在の品質レベルだけを前提とすると研磨材が不要になるという懸念は確かにあります。し

かし、半導体を中心とするエレクトロニクス製品は、高精度・高密度へのあくなき追求を続け、研磨そのものも高いレベルで進化を続けるものと思われます。私も常には常に次世代技術を研究するとともに、高精度研磨の新たな市場創出と発見に努めています。「研磨」という技術は、下の参考資料を見てもわかるように、人類の文明発展の礎となった技術のひとつだけに、さらに高い次元の発展を果たすものと考えています。

新石器時代	<p>削り、磨き、研ぐ。あるいは硬い石を砕いて、粉にし、ふるい分けるものを創り出す知恵と技術によって道具が生まれ、暮らしの進化が始まった。木片、骨片、石片、農耕具など。</p> 
紀元前200～600年頃	<p>装身具（アクセサリー）として使われた曲玉や管玉など。</p> 
その後	<p>宝石、時計、レコード針、カメラのレンズ、めがねレンズ、テレビのブラウン管・機械部品、精密機械・電子材料など</p>

**Q7** 景気は上向きつつありますが、それにもかかわらずいろいろな企業が人員整理、部門の見直し、多角化の縮小などのリストラ策を講じています。フジミも事業の効率化に向けた取り組みをお考えでしょうか。  
(徳島県 28歳 女性)

**A7** 事業の効率化に向けたリエンジニアリング、リストラクチャリングといった課題は、好況不況にかかわらず進めるべき恒久的なテーマと考えています。

当社では、日頃から最小限の人員で、最大の成果を生み出せるよう機械化による自動化も着実に進めてきました。今後も長期的な視野に立って、日々の業務の中でより効率的で機動的な経営体質を強化・改善したいと考えています。一例としまして、今期より基幹系ならびに情報系のコンピュータシステムの見直し改善に着手しており、IT技術を活用した情報の共有化、意思決定の迅速化、業務の効率化、人員の最適配置などを実現することで企業体力の強化をめざしています。

**Q8** 高株価対策としてどんな対策をとられていますか。(愛知県 46歳 男性)

**A8** 株価は、あくまでも市場の厳正な評価であると考えています。当社としては、業績の向上によって市場から評価され、株主の皆様にもリターンを得ていただきたいと考えています。従って、業績の向上と利益の還元を第一の目標とし、経営環境が悪化してもEPS(一株当たり利益)を下げないような努力を続けていきます。また、第47期定時株主総会では自社株消却を可能にするための定款変更を実施しました。加えて積極的なIR活動により、当社の業績を正しくご理解いただくことも大切だと考えています。

**Q9** IR活動の姿勢を評価しています。できればホームページでも「工場見学会」のような会社動向の開示を希望します。(東京都 62歳 男性)

**A9** 当社のIR活動については、外部からも一定の評価をいただいています。最近では、インターネットを活用したタイムリーな情報開示が普及しつつあり、当社としてもさらに充実をはかるためご希望のようなホ

ームページを来期の開設を目標に準備を進めています。

**Q10** 株主総会の開催日が他社と同じ集中日になっているのはフジミらしくないと思います。来年度は集中日以外に株主総会をずらしていただけないでしょうか。(愛知県 67歳 男性)

**A10** 株主総会の開催日は、決算書類の作成に要する時間、取締役会の承認、会計監査人や監査役の監査日程などを考慮しますと3月決算企業が多いため、6月下旬に集中するものと思います。株主総会のあり方を見直す機運は確実に高まっており、私どもとしても「開かれた総会」をめざし、より多くの株主の皆様のご出席を願えるよう一斉集中日を避けて総会開催をはかりたいと考えています。

**Q11** フジミの世界的な実力を知っていただくためにも、東証上場と上場ポストの変更を行った方がよいと思うのですが。(岐阜県 50歳 女性)

**A11** 上場のメリットは、「信用力の向上」「人材の確保」「株取引の活発化」などにあるといわれます。実に魅力ある課題です。ただ、どこの系列にも属さない独立した企業としての成長を考えた場合、まだまだ足腰をしっかりと強固なものにしなければならぬと考えています。上場基準を満たしつつ株式市場の実勢を見極めながら、いつでもステップアップできる体制を整備したいと思います。

**Q12** 越山社長は以前高校の教員をされていたようですが、その頃の経験が何か経営に活かされていますか。(東京都 35歳 男性)

**A12** 高校の体育教師を8年間やってきました。生徒に接する際には、公正な評価や公平な姿勢を貫くよう心がけていました。また一人の人間としてのふれあいも大切にしていました。その点は、今の会社においても同様で、社員一人ひとりの成長の芽を摘むことなく、その持ち味を十分生かしつつ、共通の目標に向けてベクトル合わせができるかどうかを考えています。私自身は、企業の価値は最終的には人にいきつくと考えています。米国企業では、マネジメントのリーダーシップが強く求められていますが、先頭に立つ人間として常に課題に正面からぶつかっていく勇氣を持ち続けたいと思っています。

**Q13** 前々からフジミの社名の由来について聞いてみたいと思っていたのですが。(千葉県 64歳男性)

**A13** フジミの名前の由来は、当社の事業基盤となった不二見焼合資会社(現・不二見セラミックス株式会社)から来ています。当社の創業者である故越山照次が勤務していました。その後、独立し研磨微粉の生産にたずさわる際に、「不二見」の名をもらい受け不二見研磨材工業株式会社を設立しました。平成3年10月に国内関連会社3社を合併し、現社名に商号変更しました。



創業者 故 越山照次

## 株主の皆様へ

株主の皆様にはいつも大変お世話になっております。ここに当社の平成11年4月1日から9月30日までの取り組みをお伝えする第48期中間事業報告を兼ねた株主通信の第9号を送らせていただきます。今号では、当社の現状を少しでもご理解をいただければとの願いを込めて、先の株主様向けのアンケート葉書で寄せられた貴重なお声に、私どもがお答えしています。私自身、寄せられた葉書のすべてに目を通させていただきました。皆様からのお声に、今さらながら責任の重さを痛感するとともに、勇気づけられる思いでいっぱいです。ここにあらためて感謝を申し上げます。

## フジミを取り巻く事業環境

さて、日本経済を取り巻く経済環境もこの夏頃から次第に明るいニュースが増えつつあるようです。とりわけ半導体市場は、いち早く上昇機運にあり、当社もこの機会をとらえて、業績の向上をはかるべく、全社をあげて取り組んできました。

しかし、当中間期にかぎって申し上げますと、これまで健闘してきたハードディスク用ポリシング材が、ディスク1枚当たりの記録密度が急速に向上し、ハードディスクドライブ(HDD)におけるディスク搭載枚数が短期間に減少するという、かつてない市場の大きな変化に見舞われました。

その他の製品については、概ね順調に推移しています。シリコンウェファー関連では、パソコンや携帯電話市場の堅調な推移、DRAM(記憶随時書込み読み出しメモリ)市況の急回復により、需要

も確実に伸びており、当社のラッピング材およびポリシング材の売上は順調に増加しています。

水晶用ラッピング材は、携帯電話向けの水晶振動子や水晶発振子が予想を上回るペースで伸びたことを受け、こちらも増加しました。

今、注目のCMPスラリーは、国内外のデバイスメーカーでの採用が順調に進み、売上高は大幅な増加となりました。この勢いは今後さらに加速されるものと考えています。

研磨機等機械などの商品販売におきましては、ユーザーの設備投資抑制姿勢が今期に入っても変わらず、大幅な減少となっています。市況の回復待ちと予想されます。

## 次の飛躍に向けて

半導体市況の本格回復によってシリコンウェファー関連をはじめとする当社製品は、今後も順調に伸長していくものと思われます。ただ、ディスク関連はデジタル家電等の新規需要が期待できるものの、環境の変化により厳しい状況が続くものと予想しています。

私どもとしましては、設備予算の見直しを進め、全社的なコスト低減対策をとることで、売上高経常利益率20%の確保に努めてまいります。

ただ、当社の中長期経営戦略に不可欠な 1) 各務原工場およびフジミアメリカにおいて進めているCMPスラリー設備の増設工事、2) 2000年5月の完成をめざしている機能材工場(仮称)、3) マレーシア・クーリム地区における工場建設の3件については、計画通り実行に移します。

また、これは社内的な動きですが、今期、認証

取得をめざしているISO14001の精神を生かすため、この10月1日より「品質保証本部」を『品質・環境本部』に、また「ISO推進室」を『環境管理部』にそれぞれ改称し、当社の環境マネジメントに取り組む姿勢をさらに明らかにしました。



代表取締役社長 越山 彰

## 今後も株主の皆様とともに

企業の業績は、ときに予想を超える大きな変化に見舞われます。経営に責任ある者としては一喜一憂している間もありませんが、株主様には当社の動きを正しく伝え、喜び苦しみをときには共有しつつ、フジミをさらに皆様のご期待に応えられる強固な基盤をもつ会社になりたいと考えています。

その意味でこの株主通信は、株主の皆様と当社を結ぶ絆であり、私どもが常に誠実でありたいとする一つの証でもあります。今後も機会あるたびに皆様のご意見やご要望に耳を傾け、皆様とともに歩む決意を明らかにできればと考えています。どうかこれからもフジミをよろしくお願いいたします。

平成11年12月

代表取締役社長

越山 彰

## 中間貸借対照表

### 流動資産・流動比率

当中間期は流動資産が前期末比18.5億円増加しておりますが、これは設備投資等支出額の減少による現預金の増加によるものです。流動負債も増加しており、流動比率は同7.4ポイント減の419.0%になりました。

短期借入金は現先による運用残高であり、前期末比7百万円の減少となっております。

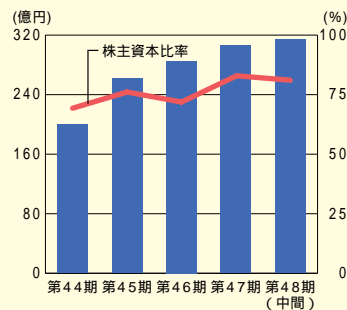
### 設備投資

当中間期の設備投資は、各務原工場のCMPスラリー製造設備、乾燥場増設工事および新研究所設計費等で総額5.7億円となりました。機械および装置等の減価償却により有形固定資産は前期末比2.5億円減の124.1億円となりました。

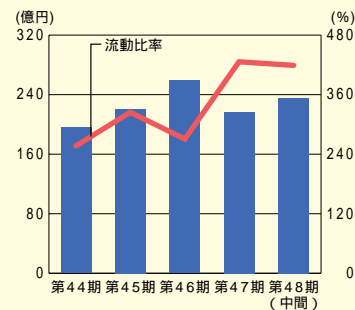
(単位：百万円、百万円未満は切り捨てています。)

	第48期中間期 平成11年9月30日現在	第47期中間期 平成10年9月30日現在	第47期 平成11年3月31日現在
<b>資産の部</b>			
流動資産	<b>23,542</b>	23,696	21,683
現金及び預金	<b>6,652</b>	4,216	4,946
受取手形	<b>2,634</b>	4,870	2,548
売掛金	<b>4,100</b>	3,936	4,053
棚卸資産	<b>1,975</b>	1,989	1,968
短期貸付金	<b>7,824</b>	8,496	7,898
その他流動資産	<b>399</b>	290	357
(貸倒引当金)	<b>71</b>	104	89
固定資産	<b>15,235</b>	14,723	15,225
有形固定資産	<b>12,413</b>	12,784	12,667
無形固定資産	<b>84</b>	34	35
投資等	<b>2,738</b>	1,904	2,522
資産合計	<b>38,750</b>	38,419	36,908

株主資本・株主資本比率



流動資産・流動比率



注) 第44～47期は年度末の数値、第48期は中間期末の数値となっております。

(単位：百万円、百万円未満は切り捨てています。)

	第48期中間期 平成11年9月30日現在	第47期中間期 平成10年9月30日現在	第47期 平成11年3月31日現在
<b>負債の部</b>			
流動負債	<b>5,619</b>	7,649	5,086
支払手形	<b>886</b>	2,548	888
買掛金	<b>2,012</b>	2,210	2,084
短期借入金	<b>540</b>	538	396
その他流動負債	<b>2,180</b>	2,352	1,715
固定負債	<b>1,727</b>	1,369	1,228
長期借入金	<b>676</b>	320	192
その他固定負債	<b>1,051</b>	1,049	1,036
負債合計	<b>7,346</b>	9,019	6,314
<b>資本の部</b>			
資本金	<b>4,753</b>	4,753	4,753
法定準備金	<b>5,282</b>	5,234	5,252
剰余金	<b>21,368</b>	19,412	20,588
資本合計	<b>31,404</b>	29,400	30,594
負債及び資本合計	<b>38,750</b>	38,419	36,908

## 負債

支払債務は前期末比ほぼ横ばいですが、未払税金および短期借入金の増加により、流動負債は5.3億円増加しております。

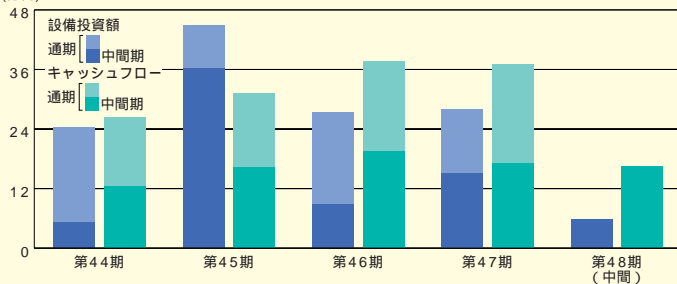
固定負債は新たに新研究所建設資金を借り入れたことにより、長期借入金が4.8億円増加しており、負債総額では前期末比10.3億円の増加となっております。

## 株主資本

第47期の内部留保により、株主資本は前期末比8.1億円増加いたしました。が、負債の増加もあり株主資本比率は同1.9ポイント減の81.0%となりました。

## 設備投資額・キャッシュフロー

(億円)



注) 第44～47期は年度末の数値、第48期は中間期末の数値となっています。

キャッシュフロー=当期利益+減価償却費-配当金-役員賞与金

## 中間損益計算書

### 売上高

パソコンや携帯電話が堅調に推移し、DRAM（記憶随時書込み読出しメモリ）市況の急回復により、シリコンウェファ－用ラッピング材およびポリシング材の売上は前期比10.5%の増加となりました。

一方、ディスク用ポリシング材はディスクの高機能化、高容量化が進み、HDD（ハードディスクドライブ）におけるディスク搭載枚数の短期間の減少により前期比26.0%の大幅な売上の減少を余儀なくされました。研磨機等機械の商品売上の大幅減もあり、総売上高は前期比20.4%の減少となりました。

### 売上原価・ 販売費及び一般管理費

研磨機等機械の商品仕入れが減ったことなどにより売上原価も減少、売上原価率は6.6ポイント減少いたしました。販売費及び一般管理費は人員の増加による人件費の増加はあったものの事業税の表示区分の変更により1.9億円少なく表示されている関係で2.3%の増加となっております。

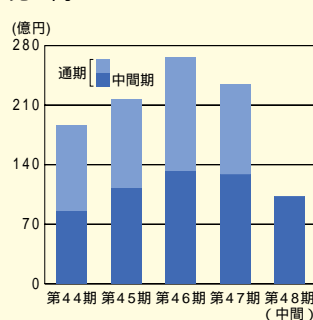
### 経常利益・中間利益

経常利益は前期比0.5%の増加となっておりますが、事業税の表示区分の変更がなかった場合は9.2%の減少となります。中間利益は同6.2%減の11.0億円となりました。

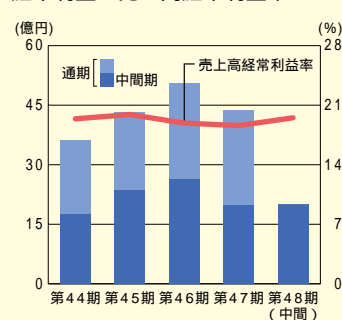
（単位：百万円、百万円未満は切り捨てています。）

	第48期中間期 平成11年4月1日から 平成11年9月30日まで	第47期中間期 平成10年4月1日から 平成10年9月30日まで	第47期 平成10年4月1日から 平成11年3月31日まで
売上高	10,259	12,882	23,477
売上原価	6,793	9,379	16,592
販売費及び一般管理費	1,506	1,472	2,749
営業利益	1,959	2,031	4,134
営業外損益			
営業外収益	60	67	276
営業外費用	16	104	27
経常利益	2,003	1,994	4,383
特別損益	11	9	51
税引前中間（当期）利益	2,015	2,003	4,434
法人税及び住民税	—	830	—
法人税、住民税及び事業税	914	—	1,888
中間（当期）利益	1,100	1,173	2,546
前期繰越利益	328	399	399

売上高



経常利益・売上高経常利益率



注) 第44～47期は年度末の数値、第48期は中間期末の数値となっております。

### 機能材工場の建設に着手

新しい表面処理・加工用材料の開発・生産を目的とする機能材工場（仮称）が11月に着工されました。岐阜県各務東町工業団地内に2000年5月の完成をめざしています。市場では、付加価値の高い研削用ペレットをはじめ多機能な表面改質材料が求められており、そうした新しいニーズに迅速に対応できる研究開発と生産体制のバランスがとれた工場をめざしています。



機能材工場完成予想図

### フジミコーポレーションを100%子会社に

米国における販売拠点として、1984年6月に設立した折半出資会社フジミコーポレーション（FUJIMI CORPORATION イリノイ州）を、この11月に100%子会社化しました。変化のスピードを増す半導体・ディスク市場に対応するには、米国市場での販売戦略をより明確にかつ強化する必要があると判断したためです。米国における当社関係会社は、1988年5月に生産拠点として設立したフジミアメリカ（FUJIMI AMERICA INC. オレゴン州）とあわせて2社に。米国における製販の協調体制が実現しました。

### マレーシアでの現地生産を計画

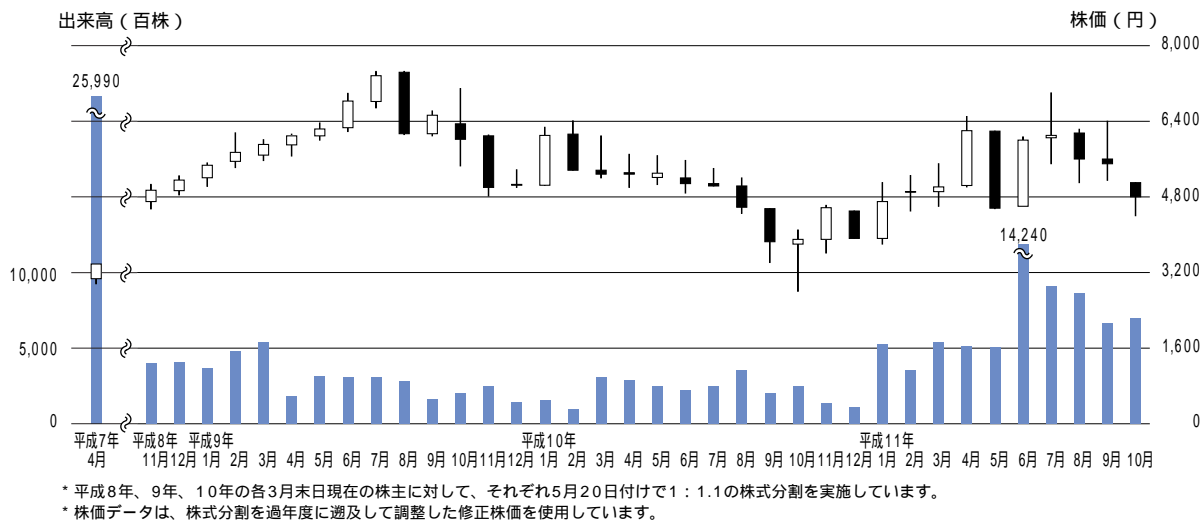
マレーシア・クーリム地区に生産工場建設を計画しています。アセアン地域には、多数の当社ユーザーが進出し大消費地を形成しており、今後も集中が一層進むものと予想されています。すでに販売会社としてフジミマイクロテクノロジー（FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.）を配置していますが、現地生産工場を建設することで、納期短縮やサポート体制強化など顧客サービス向上による競合他社との差別化をはかるとともに、急速な市場変化に伴う製品切替リスクの低減を狙います。



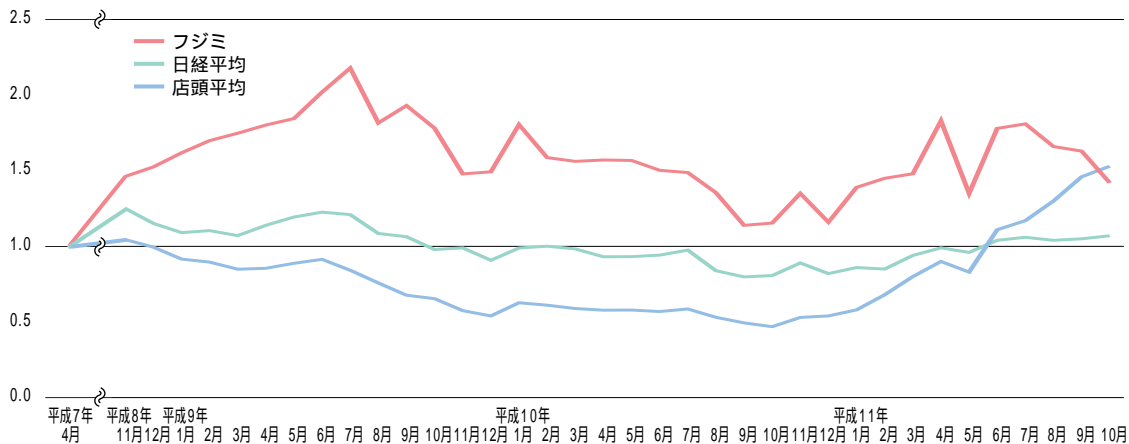
### 環境管理部を設置

10月1日より「品質保証本部」を『品質・環境本部』と改称、また「ISO推進室」にかわって『環境管理部』を設置しました。環境マネジメントに対する取り組み強化により、全従業員で地球環境保全の重要性を認識し、事業活動が与える環境負荷をより低減していくための継続的改善活動によって、経営体質の一層の強化をはかるとして目的としています。

## 修正株価および出来高の推移



## 株価の推移比較（フジミ・日経平均・店頭平均）



\* 毎月の終値を、フジミが店頭公開した平成7年4月の株価（4月の終値）を1として指数化しています。フジミの株価が市場全体の動きに比べて、どのように変動しているかを示しています。

## 会社データ (平成11年9月30日現在)

### 商号

株式会社フジインコーポレーテッド

### 証券コード

5384

### 本社所在地

愛知県西春日井郡西枇杷島町地領2丁目1番地の1  
TEL. 052-503-8181(代表)

### 設立年月日

昭和28年3月20日

### 資本金

4,753,438,500円

### 代表者

代表取締役社長 越山 彰

### 従業員

370名

## 役員

代表取締役会長	越山 勇
代表取締役社長	越山 彰
専務取締役	中村 定夫
取締役相談役	梅木 禮之輔
取締役	樋渡 利雄
取締役	藤本 俊之
取締役	久保 昌昭
取締役	永利 正志
取締役	児玉 一孝
常勤監査役	新家 秀春
常勤監査役	池本 富春
監査役	山口 正之
監査役	大矢 晃三

## 株主メモ (平成11年9月30日現在)

### 株式の状況

#### 株式数

会社が発行する株式の総数 ..... 40,000,000株  
発行済株式総数 ..... 15,602,450株  
株主数 ..... 4,728名

### 大株主

株主名	持株数	持株比率
越山 勇	1,944,155株	12.5%
野田 純孝	1,693,400	10.9
株式会社あさひ銀行	726,992	4.7
有限会社コマ	567,180	3.6
越山 彰	530,700	3.4
東洋信託銀行株式会社	418,100	2.7
三井信託銀行株式会社	400,300	2.6
株式会社東海銀行	366,025	2.3
フジインコーポレーテッド従業員持株会	337,054	2.2
日本生命保険相互会社	319,440	2.0

#### 決算期

3月31日

#### 配当金交付株主確定日

3月31日

#### 基準日

3月31日

#### 1単位の株式の数

100株

#### 公告掲載新聞

日本経済新聞

#### 名義書換代理人

東京都中央区日本橋茅場町  
1丁目2番4号

日本証券代行株式会社

#### 同事務取扱場所

名古屋市中区栄  
3丁目8番8号

日本証券代行株式会社  
名古屋支店

#### 同取次所

日本証券代行株式会社  
本店・各支店および各出張所



株式会社フジミインコーポレーテッド

お問い合わせ先：経営企画室企画課

TEL：052 - 503 - 8181(代表)